仅供内部参考，请勿外传

电子

玻璃基板产业化加速，电子半导体涨声四起

玻璃基板成为 AI 时代先进封装最优解，京东方引领国产厂商加速突破。相比传统有机树脂基板，玻璃基板展现出跨代式的物理性能优势。玻璃材料具备极高的大尺寸平整度与极低的翘曲率，其次玻璃的热膨胀系数可通过成分调节至约 3-9ppm/°C，与硅片（约 2.6 ppm/°C）实现高度匹配，从而显著降低了热循环引起的机械应力。此外，玻璃作为绝佳的绝缘体，dk 及 df 参数表现优秀，能大幅降低传输损耗并保障高速下的信号完整性。5 月 20 日晚，京东方发布与康宁公司签订合作备忘录的公告，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。据此前京东方公告，公司于 2024 年投资 9.93 亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。

AI 驱动先进硅片需求高景气，价格有望持续上行。AI 持续高景气，GPU、HBM 带来 12 英寸硅片增量需求。根据 SUMCO 测算，AI 服务器对 12 英寸硅片的需求量是通用型服务器的 3.8 倍。新产品新技术催生 12 英寸硅片更多消耗，同等存储容量 HBM 对 12 英寸硅片需求量是目前主流 DRAM 产品的 3 倍。此外随着 NAND
根据目前技术路线预计所有厂商均会切换至通过 2 片晶圆键合制作 1 个 NAND
预计，2030 年全球半导体市场规模有望达到万亿美元，假设保持现有增速，全球半导体硅片市场规模届时有望翻倍，预计超过 200 亿美元。

AI 基础建设驱动 MLCC 需求大增。据中国台湾经济日报消息，全球被动元件龙头村田表示，AI 大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达 GB300 平台为例，需搭载约 3 万颗 MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一 AI 机柜更消耗高达 44 万颗 MLCC。从需求端看来，村田预估，AI 服务器用 MLCC 需求将以年平均成长率 30%的速度呈现扩大，2030 年相关需求将较 2025 年大增 3.3 倍。根据 Business Research Insights，2025 年全球 MLCC 市场规模为 348.95 亿美元，预计到 2034 年将达到 1092.2 亿美元。高端 MLCC 占用产能多、扩产周期长，短期内有效产能很难快速扩张。2025 年下半年至 2026 年 2 月，MLCC 现货价格上涨约 20%，被动元件进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，价格涨幅普遍在 5%至 30%，高端品类的价格涨幅更高。Trend
预计，年底 AI 服务器新餐品将加大对高端 MLCC 需求，从而推高价格。

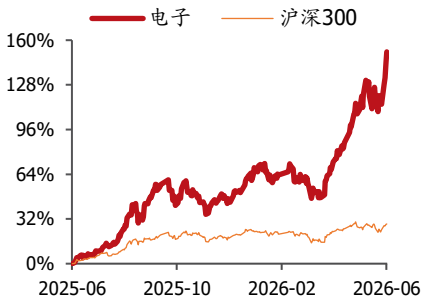
CCL 价格持续上涨，台股 CCL 公司月度营收强劲增长。6 月 16 日建滔正式发布新一轮产品涨价函，宣布旗下所有规格
固化片统一上调价格，涨幅达 15%，本次调价自新订单接单之日起正式执行。此次为建滔年内第五次提价，产品累计涨幅超 50%。我们判断伴随 2026 年下半年更多高端 PCB 产品放量，CCL 价格有望持续上行。台光 2026 年 5 月实现营收 156 亿新台币，同比增长 114.6%。台耀 2026 年 5 月实现营收约 48 亿元新台币，同比增长 129%。我们判断台系 CCL 厂商的业绩充分印证行业需求高景气，全球产业链一体化背景下我们判断国产 CCL 厂商业绩有望同步跟随强劲增长。

周观点：见相关标的。

风险提示：下游需求不及预期、研发进展不及预期、地缘政治风险。

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 余凌星
执业证书编号：S0680525010004
邮箱：shelingxing1@gszq.com
分析师 钟琳
执业证书编号：S0680525010003
邮箱：zhonglin1@gszq.com
分析师 查显彪
执业证书编号：S0680525010001
邮箱：zhaxianbiao1@gszq.com

相关研究

1、《电子：周观点：磷化铟供需错配显著，重视国产替代机遇》 2026-06-13
2、《电子：玻璃基板系列报告：AI 算力时代先进封装核心材料》 2026-06-11
3、《电子：周观点：Rubin 进入全面量产阶段，存储涨价趋势延续》 2026-06-06

重点标的

股票代码	股票名称	投资评级	EPS（元）				PE			
			2025A	2026E	2027E	2028E	2025A	2026E	2027E	2028E
002384.SZ	东山精密	买入	0.76	4.11	12.92	20.53	329.10	66.47	21.12	13.30
000725.SZ	京东方 A	买入	0.16	0.21	0.36	0.47	26.70	31.10	18.24	13.95
688167.SH	炬光科技	买入	-0.43	0.75	1.86	2.53	-	527.26	211.34	155.45
603986.SH	兆易创新	买入	2.35	10.97	15.17	18.26	133.20	57.35	41.45	34.45
300476.SZ	胜宏科技	买入	4.39	11.29	18.29	24.40	71.40	32.68	20.18	15.12
002371.SZ	北方华创	买入	10.18	13.05	16.49	-	39.00	55.27	43.72	-
688012.SH	中微公司	买入	3.37	3.50	4.47	5.84	104.50	102.74	80.56	61.60
688820.SH	盛合晶微	买入	0.49	0.62	1.07	1.48	313.30	298.56	172.78	125.04

资料来源：Wind，国盛证券研究所

内容目录

1、玻璃基板成为 AI 时代先进封装最优解，京东方引领国产厂商加速突破 4
2、AI 驱动先进硅片需求高景气，价格有望持续上行 7
3、高端 MLCC 供需趋紧，钽电容&超级电容打开应用新空间 9
4、CCL 持续涨价，高速板材加速放量 13
5、相关标的 15
6、风险提示 15

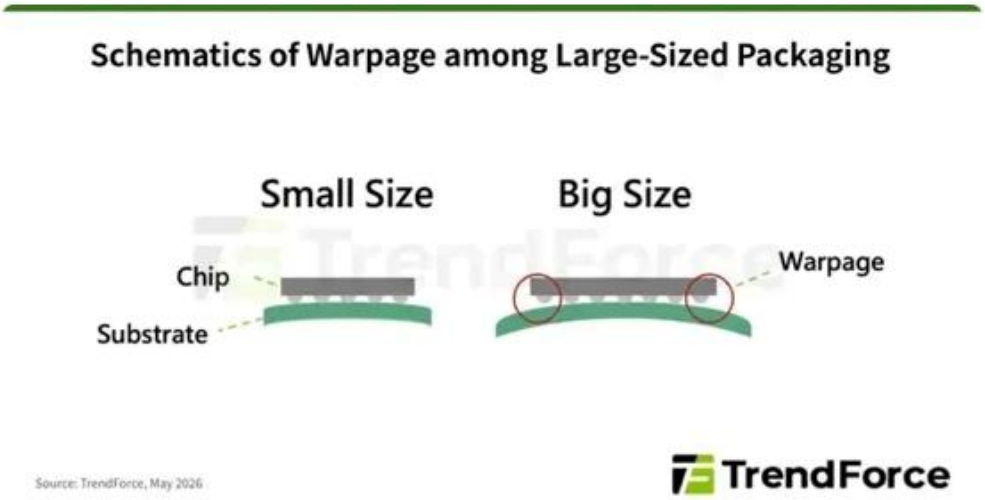
图表目录

图表 1: 有机芯基板在回流焊加热过程中会翘曲 4
图表 2: 有机载板与玻璃载板性能对比 4
图表 3: 有机载板与玻璃载板布线结构对比 4
图表 4: 玻璃基封装具有更高的面积利用率 5
图表 5: 不同封装尺寸下晶圆/面板尺寸对应的成本节省率（%） 5
图表 6: 京东方玻璃基先进封装项目工艺设备搬入仪式 6
图表 7: 京东方与康宁公司签署合作备忘录 6
图表 8: 全球不同尺寸半导体硅片出货面积（百万平方英寸） 7
图表 9: 全球半导体硅片出货面积 8
图表 10: 全球半导体硅片市场规模 8
图表 11: 200 mm 硅片趋势 8
图表 12: 300 mm 硅片趋势 8
图表 13: 用于 AI 的 DRAM 的晶圆需求 8
图表 14: 用于 AI 的 NAND 晶圆需求 8
图表 15: 用于 AI 半导体的前沿硅晶圆需求预测 9
图表 16: Sumco 客户 300mm 硅片库存情况 9
图表 17: 信越化学电子材料业绩情况 9
图表 18: 2025-2034E 全球 MLCC 市场规模（十亿美元） 10
图表 19: 村田针对搭载人工智能功能的服务器用电容器需求预测（按数量计算） 11
图表 20: 板卡上的保持电容 12
图表 21: 超级电容能够提供堪比电池的能量密度和堪比电容的功率密度 12
图表 22: 顺络电子固态聚合物钽电容相比常规液态铝电解电容体积占优 12
图表 23: 台光月度营收及同比（亿新台币） 13
图表 24: 台耀月度营收及同比（亿新台币） 13
图表 25: 建滔涨价详情 14

1、玻璃基板成为 AI 时代先进封装最优解，京东方引领国产厂商加速突破

物理与热学性能跨代跃升，玻璃基板低翘曲与高匹配度攻克超大面积封装痛点。相比传统有机树脂基板，玻璃基板展现出跨代式的物理性能优势。首先，玻璃材料具备极高的大尺寸平整度与极低的翘曲率，相较于有机基板可将超大面积封装下的翘曲变形降低 70%以上，极大改善了芯片在高温焊接和多层堆叠过程中的失效风险；其次，玻璃的热膨胀系数（CTE）可通过成分调节至约 3-9ppm/℃，与硅片（约 2.6 ppm/℃）实现高度匹配，从而显著降低了热循环引起的机械应力。

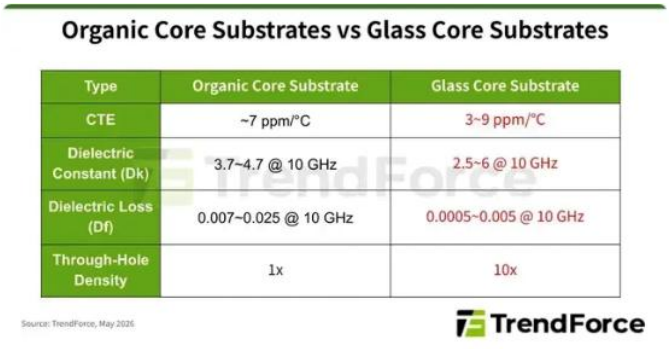
图表1：有机芯基板在回流焊加热过程中会翘曲



资料来源：Trendforce，国盛证券研究所

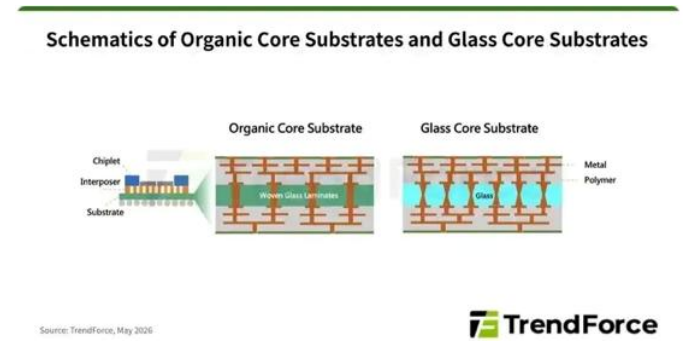
电气损耗与信号传输表现卓越，高频高速场景下保障信号完整性。在电学与信号传输方面，玻璃作为绝佳的绝缘体，在 10GHz 高频下介电常数 Dk 低至 2.5–6、介电损耗 Df 低至 0.0005–0.005，能大幅降低传输损耗并保障高速下的信号完整性。随着 AI 算力芯片对高带宽、低延迟互连的要求不断提高，玻璃基板的电气优势有望进一步加速其在高端芯片封装中的渗透。在加工精度层面，玻璃极其平整的光洁表面使其能够实现 2 微米以下的超精细 RDL 线宽/线距（L/S），且其出色的尺寸稳定性可支持互连密度实现 10 倍的跨越式增长。

图表2：有机载板与玻璃载板性能对比



资料来源：Trendforce，国盛证券研究所

图表3：有机载板与玻璃载板布线结构对比

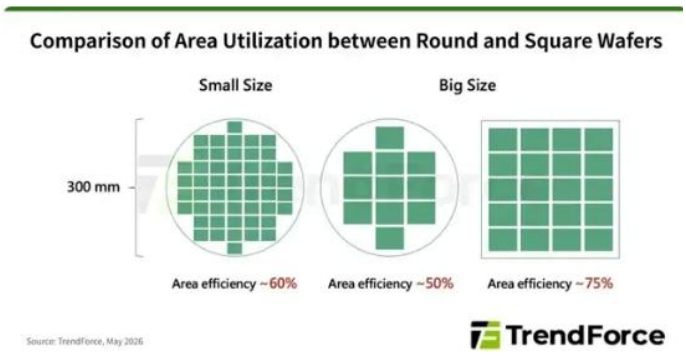


资料来源：Trendforce，国盛证券研究所

突破硅中介层尺寸掩膜版极限，面板级大面积加工打开广阔降本空间。在与硅中介层（Silicon Interposer）的竞争中，玻璃基板具备独特的尺寸扩容与成本优势。随着 AI 算力需求激增，单颗 AI 芯片的封装尺寸持续放大。尽管阿斯麦的 EUV（0.33NA）光刻，目前将最大掩模版尺寸限制在 26×33 毫米（约 830 平方毫米），但台积电采用掩模拼接技术，拼接多块掩模图形以做大芯片尺寸。英伟达 Blackwell 架构 GPU 单封装尺寸约为掩模版尺寸的 3.3 倍，面积达约 2739 平方毫米；下一代 Rubin GPU 预计扩至掩模版 4 倍尺寸，约 3320 平方毫米；Rubin Ultra GPU 更将达到掩模版 9 倍尺寸，约 7470 平方毫米。除英伟达外，谷歌 TPU v9x（Humu

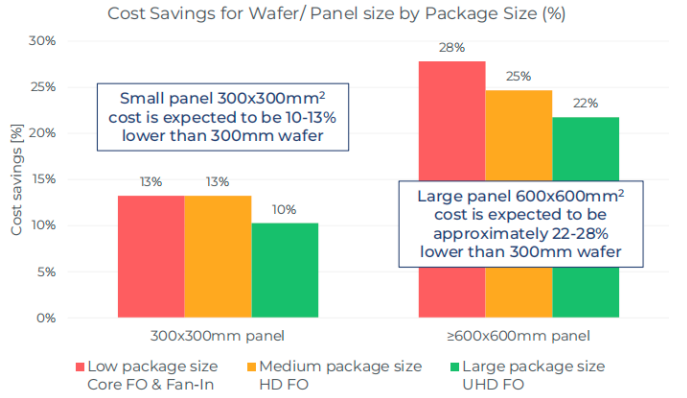
从台积电 CoWoS 掩模版尺寸路线图来看：目前 5.5 倍掩模版尺寸已量产，9 倍目标 2027 年落地，14 倍规划 2028 年，14 倍以上版本预计 2029 年推出。英特尔则计划 2028 年推出 12 倍掩模版尺寸的 EMIB 方案，匹配超大芯片封装需求。但封装尺寸持续放大，带来两大核心挑战：第一，方形大芯片难以在圆形晶圆上高效排布，晶圆边缘面积浪费严重。由此催生面板级封装（PLP）思路：以方形面板替代圆形晶圆，面积利用率可提升至 75%以上。圆晶圆与方面板面积利用率对比：300 毫米圆晶圆随芯片尺寸增大，利用率从约 60%降至 50%左右；而方形面板可稳定维持约 75%利用率，这为整合更多 Chiplet、构建单颗超大面积的 AI 芯片提供了极高的面积性价比。

图表4：玻璃基封装具有更高的面积利用率



资料来源：Trendforce，国盛证券研究所

图表5：不同封装尺寸下晶圆/面板尺寸对应的成本节省率（%）



资料来源：Yole，国盛证券研究所

大陆半导体显示面板龙头京东方（BOE）全面推进半导体玻璃基板战略。为了加速国产半导体玻璃基板的[illegible]年，京东方已大举投资高达 9.93 亿元人民币，在北京亦庄建立起了一座拥有 2000 平方公尺高规格洁净车间、集成了包括高精密原子层沉积（ALD）、光罩微影、全自动光学检测（AOI）及无电解铜镀等上百台全工艺流程核心设备的智能化半导体玻璃基封装载板中试线，**并且其板级研发样品已跨过关键技术门槛。**根据该亦庄玻璃基中试项目的最新建设日程表，其 2025 年已全面步入关键核心设备的搬入与工艺联调阶段，产业化节奏规划在 2027 年正式形成本土初始量产能力，并于 2029 年推动国产高附加值大尺寸封装技术向规模化应用迈上全新台阶。

图表6：京东方玻璃基先进封装项目工艺设备搬入仪式



资料来源：酷玩实验室，国盛证券研究所

5 月 20 日晚，京东方发布与康宁公司签订合作备忘录的公告，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作，共同探索具有商业潜力的技术与市场机会。该备忘录自双方授权代表签字之日起生效，有效期为三年。期满前如双方无异议，可经协商续签或延长。据公司公告，京东方于 2024 年投资 9.93 亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。光互连方面，公司下属子公司于 2023 年投资建设 MicroLED 芯片生产线。日前公司下属子公司的 MicroLED 光互联芯片已产出相关样品并为客户送样。

图表7：京东方与康宁公司签署合作备忘录

证券代码：000725　证券简称：京东方 A　公告编号：2026-045
证券代码：200725　证券简称：京东方 B　公告编号：2026-045

京东方科技集团股份有限公司
关于与康宁公司签署合作备忘录的公告

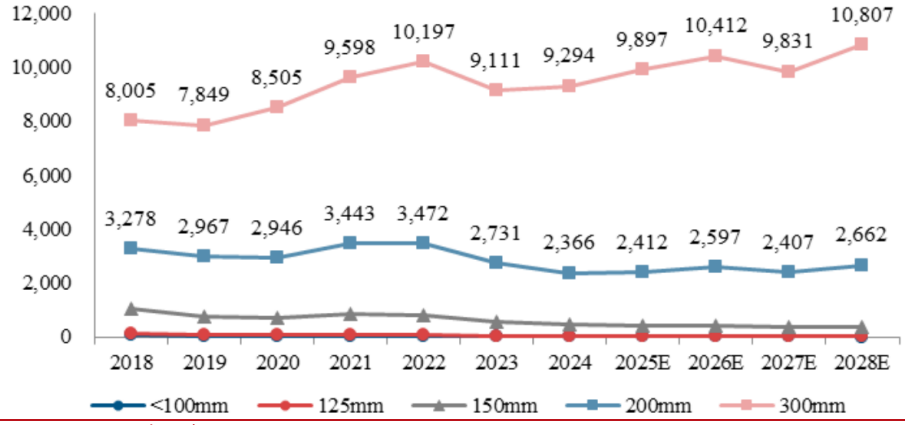
资料来源：京东方公告，国盛证券研究所

2、AI 驱动先进硅片需求高景气，价格有望持续上行

AI 持续高景气，GPU、HBM 带来 12 英寸硅片增量需求。国内外厂商加速布局大模型，带动算力需求增长，驱动 AI 服务器行业维持较高景气度，随着 AI 性能的提升和大模型参数的增加，对运算能力的需求也在快速增长，同时对硅片的需求量也会明显增长。以 AI 服务器为例，AI 服务器增加了高性能 GPU 芯片用于高速并行数据的计算，同时配套 HBM 堆栈储存计算用数据，HBM 堆栈是由 DRAM 芯片堆叠形成，堆叠层数不断提高，使得 12 英寸硅片使用量进一步提升。**根据 SUMCO 测算，AI 服务器对 12 英寸硅片的需求量是通用型服务器的 3.8 倍。**新产品新技术催生 12 英寸硅片更多消耗，同等存储容量 HBM 对 12 英寸硅片需求量是目前主流 DRAM 产品的 3 倍。此外，随着 NAND 堆叠层数提升至 400 层，按目前业内技术路线共识，所有厂商均会切换至通过 2 片晶圆键合制作 1 个 NAND

晶圆厂持续扩产拉动 12 英寸硅片需求。根据 SEMI 统计，截至 2024 年末，全球共有 193 条 12 英寸量产晶圆厂，预计到 2026 年全球 12 英寸晶圆厂量产数量将达到 230 座，将对 12 英寸硅片带来较大的需求，全球 12 英寸晶圆厂产能将从 2024 年的 834 万片/月增长至 2026 年的 989 万片/月，年复合增长率达到 8.9%，下游晶圆厂产能的快速扩张将大幅拉升 12 英寸硅片需求。中国大陆方面，根据 SEMI 统计，截至 2024 年末，中国大陆地区有 62 座 12 英寸量产晶圆厂（包含西安三星、海力士、南京台积电等外资晶圆厂），预计 2026 年中国大陆地区 12 英寸晶圆厂量产数量将超过 70 座，相应产能增长至 321 万片/月，约占届时全球 12 英寸晶圆厂产能的 1/3，其中以中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储为代表的内资 12 英寸晶圆厂产能将增至约 250 万片/月。

图表8：全球不同尺寸半导体硅片出货面积（百万平方英寸）



资料来源：SEMI，国盛证券研究所

全球半导体硅片市场逐渐复苏。自 2020 年初至 2022 年，随着居家办公需求快速增长、5G 商业化带来的换机需求及全球芯片产能紧缺等因素推动下，全球半导体产业迎来上行周期。根据 SEMI 的数据，2022 年全球半导体硅片出货面积增长至 146 亿平方英寸，达历史新高。2023 年以来，随着世界经济呈现衰退态势、消费电子周期需求下行、半导体行业处于去库存周期及国际局势紧张等多重影响，半导体行业短期有所下滑，但 2024 年随着下游复苏，半导体行业开始回暖，并逐渐向上游的半导体硅片行业传导，根据群智咨询数据，25Q4 全球主要晶圆厂平均产能利用率回升至 90%，同比增长约 7 个百分点。随着全球晶圆厂产能的持续扩张以及产能利用率逐渐回升，半导体硅片行业将持续保持景气向上的态势。根据 SEMI 预计，2030 年全球半导体市场规模有望达到万亿美元，假设保持现有增速，全球半导体硅片市场规模届时有望翻倍，预计超过 200 亿美元。

仅供内部参考，请勿外传

图表9：全球半导体硅片出货面积



资料来源：SEMI，国盛证券研究所

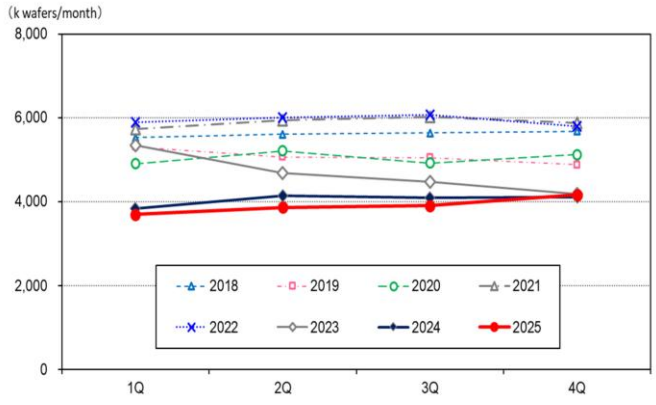
图表10：全球半导体硅片市场规模



资料来源：SEMI，国盛证券研究所

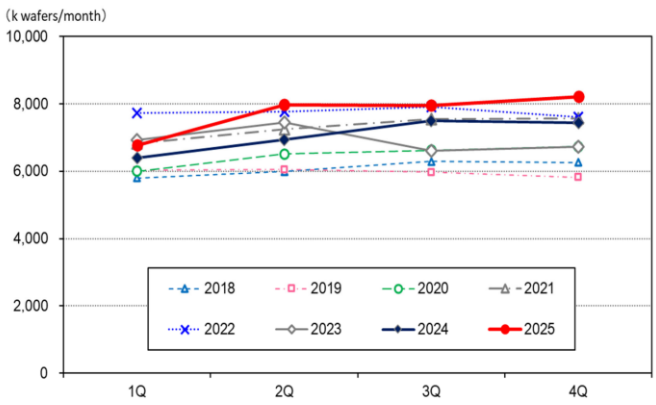
Sumco：2025 年 300mm 硅片全年复苏趋势延续，中长期展望，300mm 硅片充分受益于 AI 带动的需求高增。从 Sumco 口径来看，2025 年 300mm 硅片全年复苏趋势延续，需求保持向好，200mm 硅片出货量依旧疲软，需求未明显改善。中长期来看，1）300mm 硅片：AI 数据中心的先进逻辑芯片和 DRAM 需求旺盛，NAND 需求预计也将回升；传统产品方面，客户将全面去库存并调整采购量；2）200mm 及更小尺寸硅片：AI 数据中心领域有一定需求增长，但受向 300mm 迁移及地缘政治影响，整体需求规模预计维持当前水平。

图表11：200 mm 硅片趋势



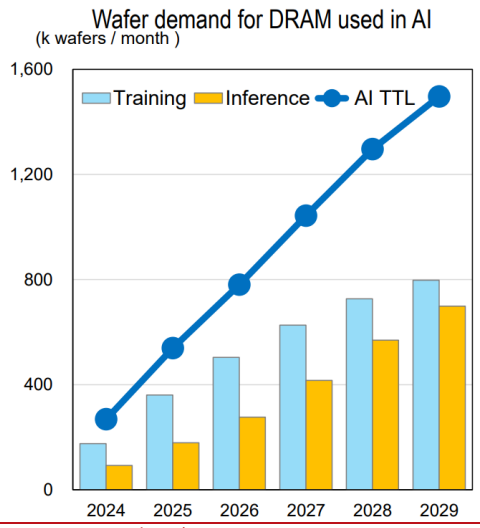
资料来源：Sumco，国盛证券研究所

图表12：300 mm 硅片趋势



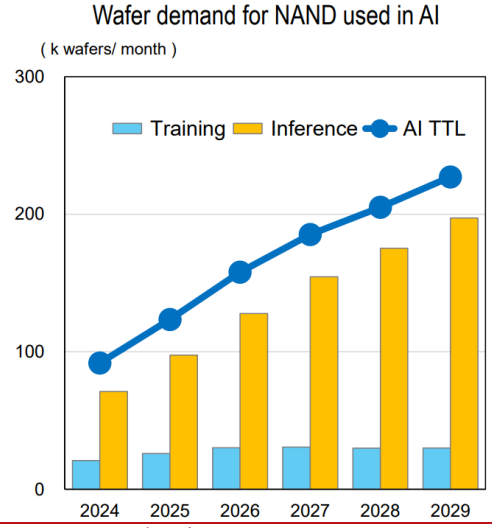
资料来源：Sumco，国盛证券研究所

图表13：用于 AI 的 DRAM 的晶圆需求



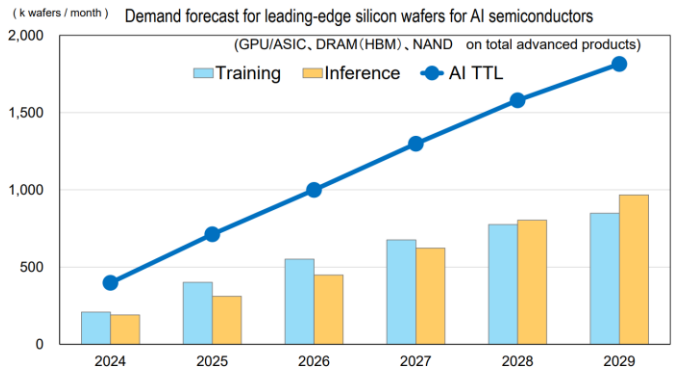
资料来源：Sumco，国盛证券研究所

图表14：用于 AI 的 NAND 晶圆需求



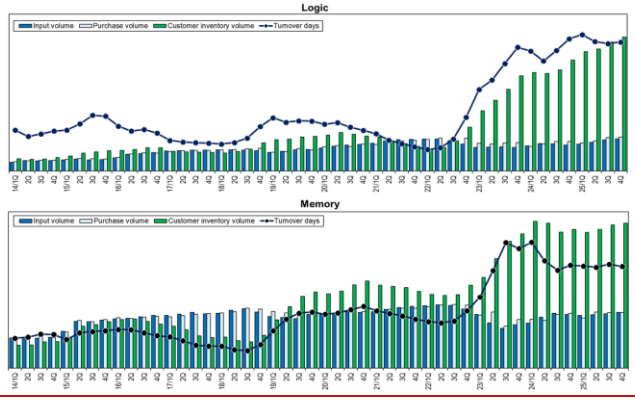
资料来源：Sumco，国盛证券研究所

图表15：用于 AI 半导体的前沿硅晶圆需求预测



资料来源：Sumco，国盛证券研究所

图表16：Sumco 客户 300mm 硅片库存情况



资料来源：Sumco，国盛证券研究所

信越化学：300mm 硅片持续复苏。信越化学口径，300mm 硅片需求呈现保持复苏态势。未来走势将很大程度上取决于各细分领域的需求情况，以及客户的库存策略。公司表示，在半导体市场中，与 AI 相关的需求持续强劲，而其他领域的需求也终于开始回升，公司抓住这一趋势，扩大了硅片、光刻胶和光掩模坯等半导体材料的销售额。展望未来，信越化学表示，在 AI 半导体领域，客户正加紧扩产，AI 需求的激增为行业的结构性变革，预计硅片需求将持续增长。受此增长影响，目前 DRAM 供应已出现短缺。在这种背景下，尤其是存储器厂商在需求增长节奏的驱动下，已开始表现出保障未来硅片供应的意愿。公司预计未来 AI 相关硅片的出货量将大幅增长。

图表17：信越化学电子材料业绩情况

Electronics Materials

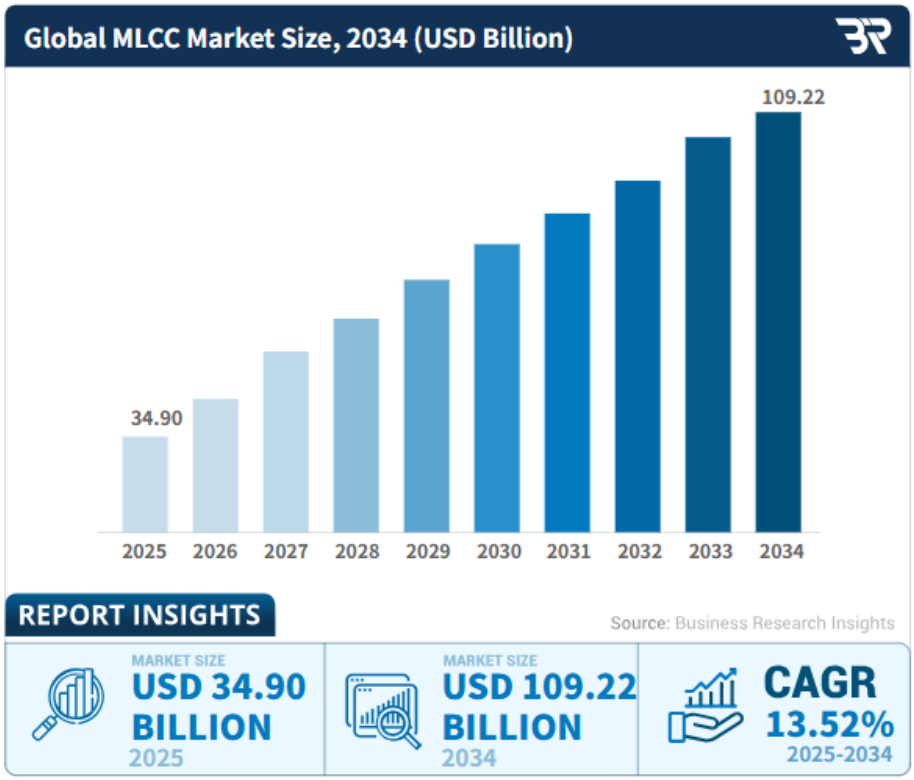
	Apr - Dec 2024 (Billions of yen)	Apr - Dec 2025 (Billions of yen)	Increase / (Decrease)
Net sales	709.1	**750.3**	6%
Operating income	260.5	**259.2**	(0%)

资料来源：信越化学，国盛证券研究所

3、高端 MLCC 供需趋紧，钽电容&超级电容打开应用新空间

AI 基础建设驱动 MLCC 需求大增。据中国台湾经济日报消息，全球被动元件龙头村田表示，AI 大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达最新 GB300 平台为例，需搭载约 3 万颗 MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一 AI 机柜更消耗高达 44 万颗 MLCC。从需求端看来，2026 年仍非常乐观。村田预估，AI 服务器用 MLCC 需求将以年平均成长率 30%的速度呈现扩大，2030 年相关需求将较 2025 年大增 3.3 倍。该公司社长中岛规巨称，随着 AI 服务器处理能力提升、搭载的 MLCC 数量也随之增加。根据 Business Research Insights 数据，2025 年全球 MLCC 市场规模为 348.95 亿美元，预计到 2034 年将达到 1092.2 亿美元，2025 年至 2034 年复合年增长率（CAGR）约为 13.52%。

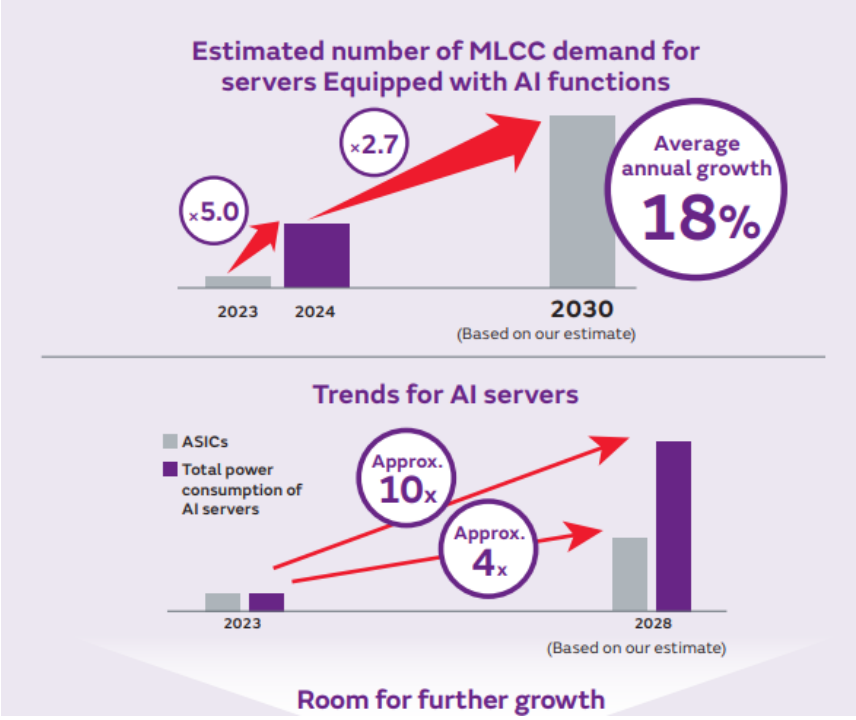
图表18：2025-2034E 全球 MLCC 市场规模（十亿美元）



资料来源：Business Research Insights，国盛证券研究所

为了支持 GPU 和 CPU 在 0.8V 低电压下消耗数千安培电流，高电容 MLCC 的需求日益增长。MLCC 的总电容必须增加才可以提供 GPU 的功率动态变化所需的稳定电源供应。英伟达的 Grace Blackwell GB200 服务器主板大约需要 6500 个 MLCC（多层陶瓷电容器），而即将推出的 Rubin 架构将使每块主板的 MLCC 数量增加到约 12000 个。与此同时，微软、AWS、谷歌和 Meta 等云服务提供商正在稳步增加对自研 ASIC 芯片和 CoWoS 先进封装技术的订单，从而推高了对高端 MLCC 的长期需求。根据村田预计，AI 服务器所需 MLCC 从 2024 至 2030 年，平均每年增长 18%。集邦咨询表示，英伟达 VR200 NVL72 服务器将使用约 60 万个 MLCC，比现有的 GB300 平台高 30%以上，囊括从 2.5V 到上千 V 的电压规格。

图表19：村田针对搭载人工智能功能的服务器用电容器需求预测（按数量计算）



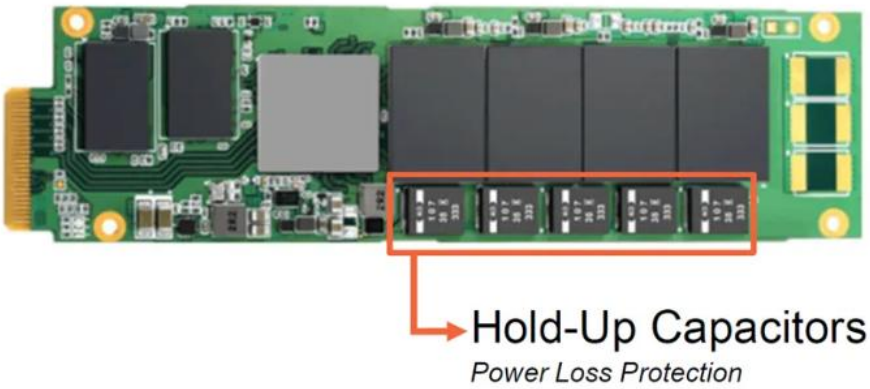
资料来源：村田，国盛证券研究所

高端 MLCC 供需趋紧，打开行业新一轮涨价周期。AI 服务器 MLCC 的格局高度集中，主要由村田和三星电机主导。两家在 2025 年下半年稼动率已达到高位。日韩厂商的扩产节奏一贯保守，在经历了上一轮“扩产—过剩—亏损”的周期后，对新建大规模产能非常谨慎，更倾向于通过瓶颈工序的局部优化来释放产能。高端 MLCC 占用产能多、扩产周期长，短期内有效产能很难快速扩张。2025 年下半年至 2026 年 2 月，MLCC 现货价格上涨约 20%，被动元件进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，价格涨幅普遍在 5%至 30%，高端品类的价格涨幅更高。**Trend**
大对高端 MLCC 的需求，从而推高价格。

与普通服务器相比，AI 服务器对 MLCC 的需求呈现“量质双升”的特点。

- ✓ 传统服务器的 CPU/GPU 切换功耗变化在 μs~ms 级，但 AI 服务器的 GPU/TPU 瞬时负载变化快达 ns~μs 级，需超高速去耦。在容量配置方面，传统服务器的容值以 μ
  数百 μ
  ESL MLCC 密集放置在封装附近（甚至 0201/01005 尺寸）。
- ✓ 在频率响应方面，传统服务器以 MHz 级为主，AI 服务器则必须覆盖数百 kHz 到数 GHz 的宽带噪声抑制。对温度／寿命要求方面，传统服务器的一般商用温度为 0~85℃或 105℃，AI 服务器则有高可靠性要求，长期运行于 85~125℃环境，并需抗直流偏压效应。
- ✓ 在封装与布局方面，传统服务器使用标准尺寸（0402~1210）即可，AI 服务器则趋向微小封装（01005/0201）与大容量迭层结构，并配合嵌入式 PCB MLCC 技术。在可靠性要求方面，普通 IEC/JEDEC 等级即可满足传统服务器的需求，AI 服务器则需通过 AEC-Q200 或数据中心级耐久与抗振规范。
- ✓ 由于 AI、大数据的应用对能量的需求更多，需要更佳的抗电磁干扰、抗噪声能力，因此 MLCC 需要更多电极层、更薄的电介质、更大的有效面积与更高的可靠性，以实现单位体积电容更高、有效电容更高，采用的材质也将从 X5R 转向 X6S，高电容密度 MLCC 已经成为 AI 服务器应用的关键部件。

图表20：板卡上的保持电容

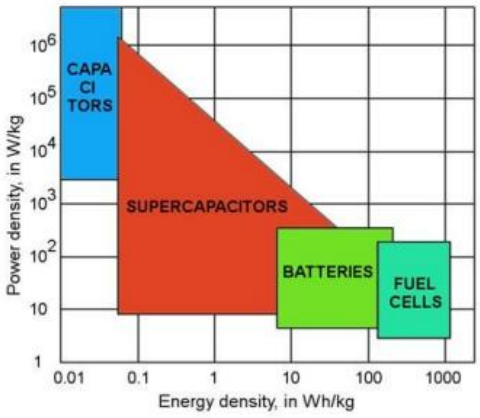


资料来源：艾睿电子，国盛证券研究所

AI 服务器同时打开超级电容与钽电容的应用空间。超级电容可以瞬时输出最大功率，在 UPS（不间断电源）系统中，超级电容器可以实现比传统电池更快、更平滑的切换过程，减少切换过程中可能出现的电压波动，确保系统的连续运行，同时超级电容具有更高的功率密度，凭借以上特性，超级电容在 AI 机柜中的应用在不断推进。谷歌数据中心部分机房已采用超级电容与锂电池混合储能系统，用于应对 GPU 集群的瞬时功率波动，降低冷却能耗 15%。根据领达科技数据，2025 年全球 AI 服务器用超级电容器收入规模约 3.67 亿元，预计到 2032 年将接近 11.07 亿元，年复合增长率 16.9%。

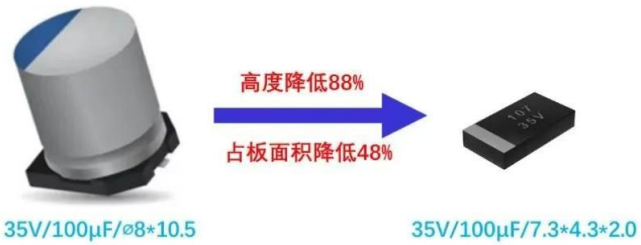
聚合物钽电容器在 AI 服务器中主要用作大容量、低 ESR 的中高频储能与去耦组件，与 MLCC 搭配形成宽频段电源稳定网络。相比传统钽电容或铝电解电容，它在 AI 服务器高功耗、高瞬态变化的环境中具有明显优势。由于 AI 应用带动钽质电容需求大增，但产能扩张相对不易，因此钽电容涨价持续。国巨集团近日通过旗下子公司基美向客户发出调价通知，宣布将对部分聚合物钽电容产品进行价格调整。新价格计划于 2026 年 4 月 1 日起正式生效。自 2025 年下半年以来，这已是该公司第三次发布钽电容涨价通知。此前，国巨曾在 2025 年 6 月对聚合物钽电容部分规格进行调价，随后于 2025 年 11 月再次调涨 T520、T521 及 T530 系列产品，当时涨幅高达 20%至 30%。

图表21：超级电容能够提供堪比电池的能量密度和堪比电容的功率密度



资料来源：ABRACON，国盛证券研究所

图表22：顺络电子固态聚合物钽电容相比常规液态铝电解电容体积占优

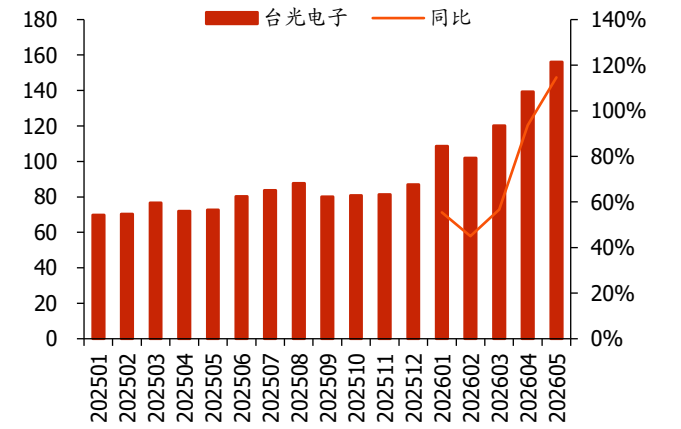


资料来源：顺络电子，国盛证券研究所

4、CCL 持续涨价，高速板材加速放量

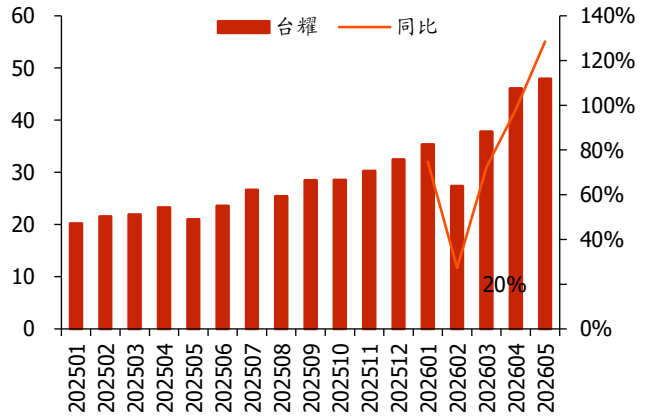
AI 带动强劲需求，台股 CCL 公司月度营收强劲增长。台光 2026 年 5 月实现营收 156 亿新台币，同比增长 114.6%。台耀 2026 年 5 月实现营收约 48 亿元新台币，同比增长 129%。我们判断台系 CCL 厂商的业绩充分印证行业需求高景气，全球产业链一体化背景下我们判断国产 CCL 厂商业绩有望同步跟随强劲增长。

图表23：台光月度营收及同比（亿新台币）



资料来源：wind，国盛证券研究所

图表24：台耀月度营收及同比（亿新台币）

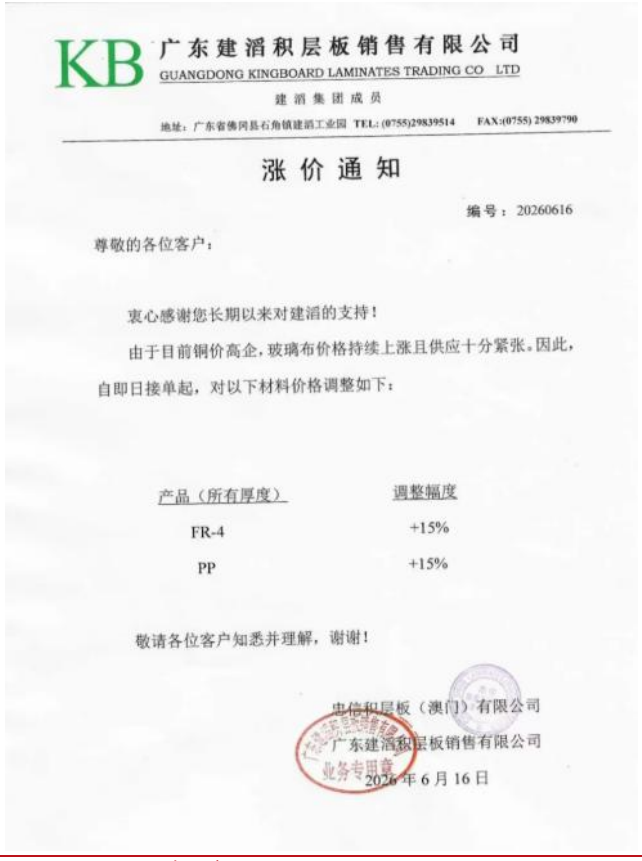


资料来源：wind，国盛证券研究所

CCL 价格持续上涨。6 月 16 日，全球覆铜板行业龙头企业建滔积层板正式发布新一轮产品涨价函，宣布旗下所有规格

本次调价自新订单接单之日起正式执行。此次为建滔积层板年内第五次提价，产品累计涨幅超 50%。此前，公司已分别于 3 月 10 日、4 月 3 日、4 月 28 日、5 月 27 日完成四轮调价。我们判断当前 PCB 行业需求旺盛，高端产品供给紧张，带动高端 CCL 需求同步旺盛价格持续上行。而大厂产能持续向高端产品转移的背景下，传统产能受到挤压价格同样跟随持续上行。伴随 PCB 行业 2026 年下半年更多高端产品放量，CCL 价格上行趋势有望贯穿全年。

图表25：建滔涨价详情



KB 广东建滔积层板销售有限公司
GUANGDONG KINGBOARD LAMINATES TRADING CO LTD
建滔集团成员
地址：广东省佛冈县石角镇建滔工业园 TEL: (0755)29839514 FAX:(0755) 29839790

涨价通知

编号：20260616

尊敬的各位客户：

衷心感谢您长期以来对建滔的支持！

由于目前铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张。因此，自即日接单起，对以下材料价格调整如下：

产品（所有厚度）	调整幅度
FR-4	+15%
PP	+15%

敬请各位客户知悉并理解，谢谢！

中信积层板（澳门）有限公司
广东建滔积层板销售有限公司
2026 年 6 月 16 日

资料来源：PCB 网城 ISPCAIGPCA，国盛证券研究所

5、相关标的

玻璃基板：京东方、天承科技、帝尔激光等；

硅片：立昂微、沪硅产业、西安奕材等；

MLCC 及产业链：三环集团、洁美科技、风华高科、博迁新材、国瓷材料；

磷化铟衬底：云南锗业；

PCB 产业链：胜宏科技、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、生益科技、天承科技、中钨高新、鼎泰高科、大族数控等；

光产业链：东山精密（索尔思）、炬光科技、腾景科技、源杰科技、豪威集团、天孚通信、中际旭创、新易盛、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、永鼎股份、太辰光、光库科技、赛微电子等；

存储芯片：兆易创新、澜起科技、东芯股份、普冉股份、恒烁股份、聚辰股份等；

存储模组：香农芯创、佰维存储、国科微、江波龙等；

半导体设备：中微公司、北方华创、拓荆科技、华峰测控、金海通等；

半导体材料：雅克科技、鼎龙股份、天承科技、彤程新材、安集科技、兴森科技、兴福电子等；

封测：盛合晶微、长电科技、通富微电、晶方科技、甬矽电子、汇成股份、伟测科技、利扬芯片等；

国产算力芯片：芯原股份、沐曦股份、海光信息、寒武纪、天数智芯、壁仞科技、摩尔线程、灿芯股份、翱捷科技等。

6、风险提示

1. 下游需求不及预期。
2. 研发进展不及预期。
3. 地缘政治风险。

免责声明

国盛证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数跌幅在-10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京
地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场东塔 7 层
邮编：100077
邮箱：gsresearch@gszq.com

上海
地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋
邮编：200120
电话：021-38124100
邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌
地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
邮编：330038
传真：0791-86281485
邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳
地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
邮编：518033
邮箱：gsresearch@gszq.com